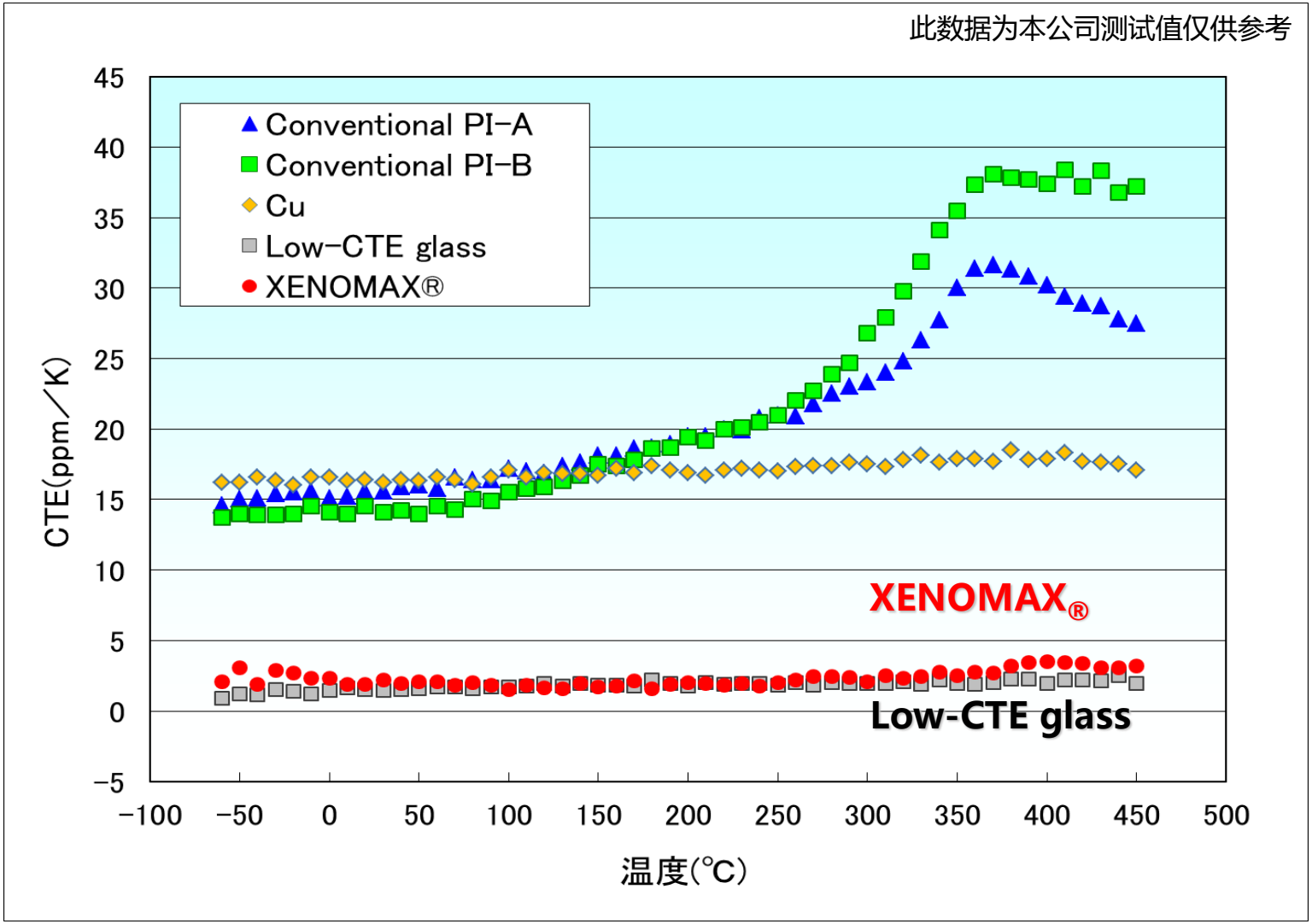
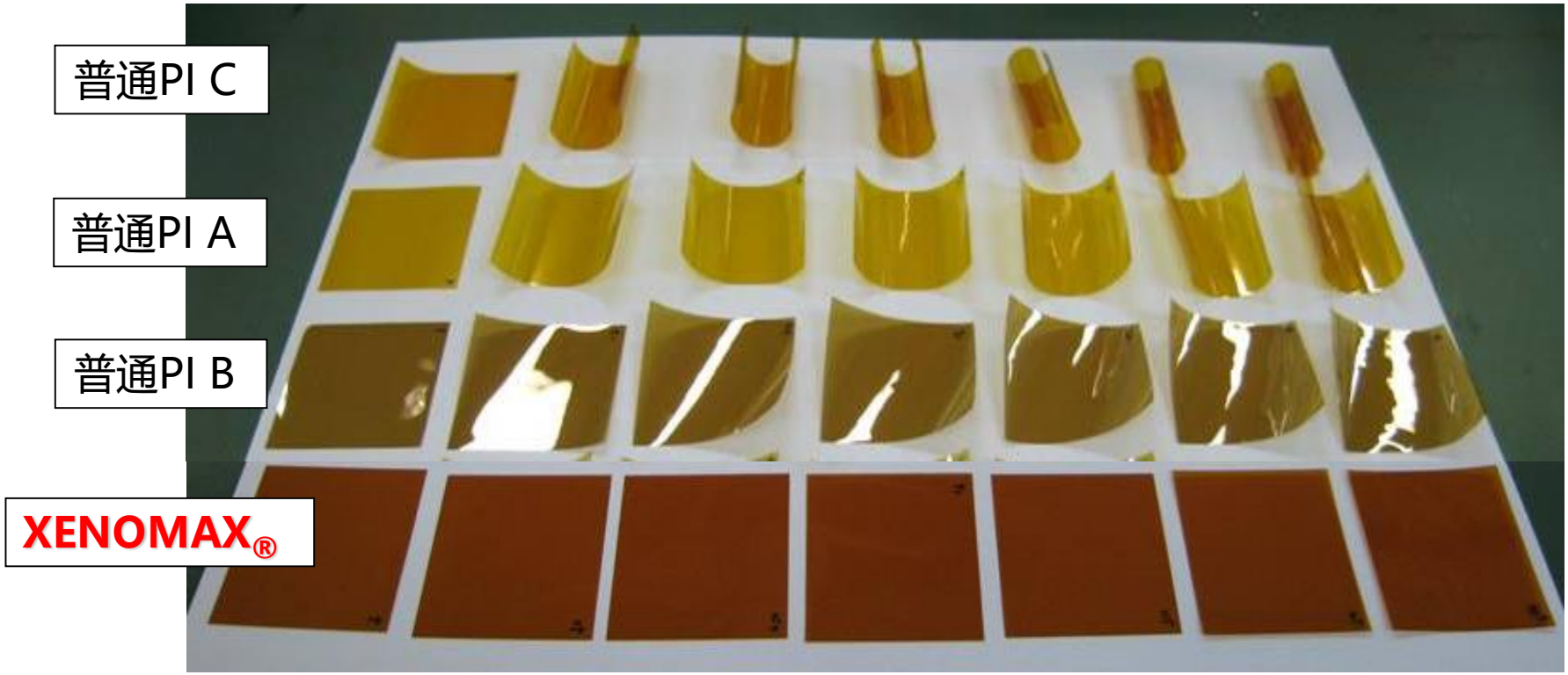
热膨胀系数（CTE）温度依存性



■ CTE在广范围保持超低CTE性

高温形状稳定性（变形）

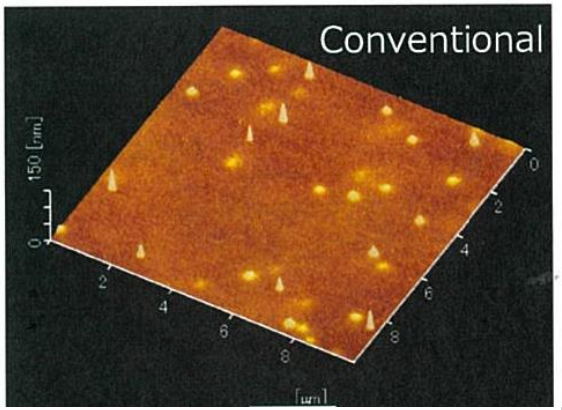
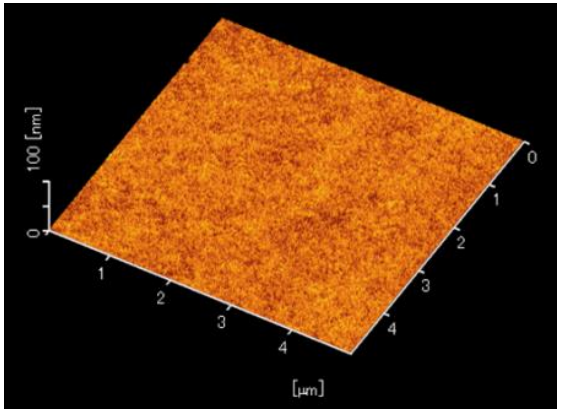
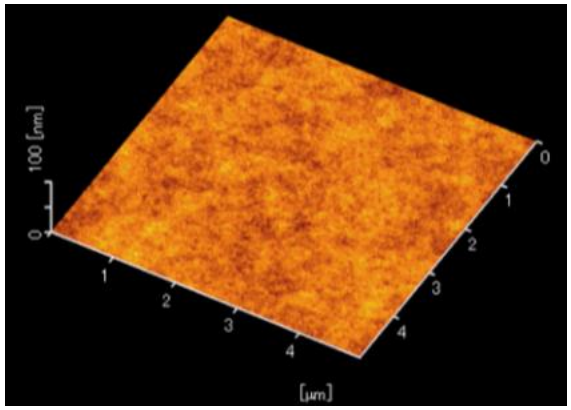


室温　200℃　250℃　300℃　350℃　400℃　450℃

使用高温板　放置5分钟

■ 拥有高温无变形性（翘曲）

表面平滑性

	普通PI膜	XENOMAX®	TFT玻璃
AFM图			
表面粗糙度Ra	3 nm	0.5 nm	0.2 nm

*AFM : Atomic Force Microscopy
**Ra : arithmetic average roughness

■ 拥有于TFT玻璃同等的高表面平滑性

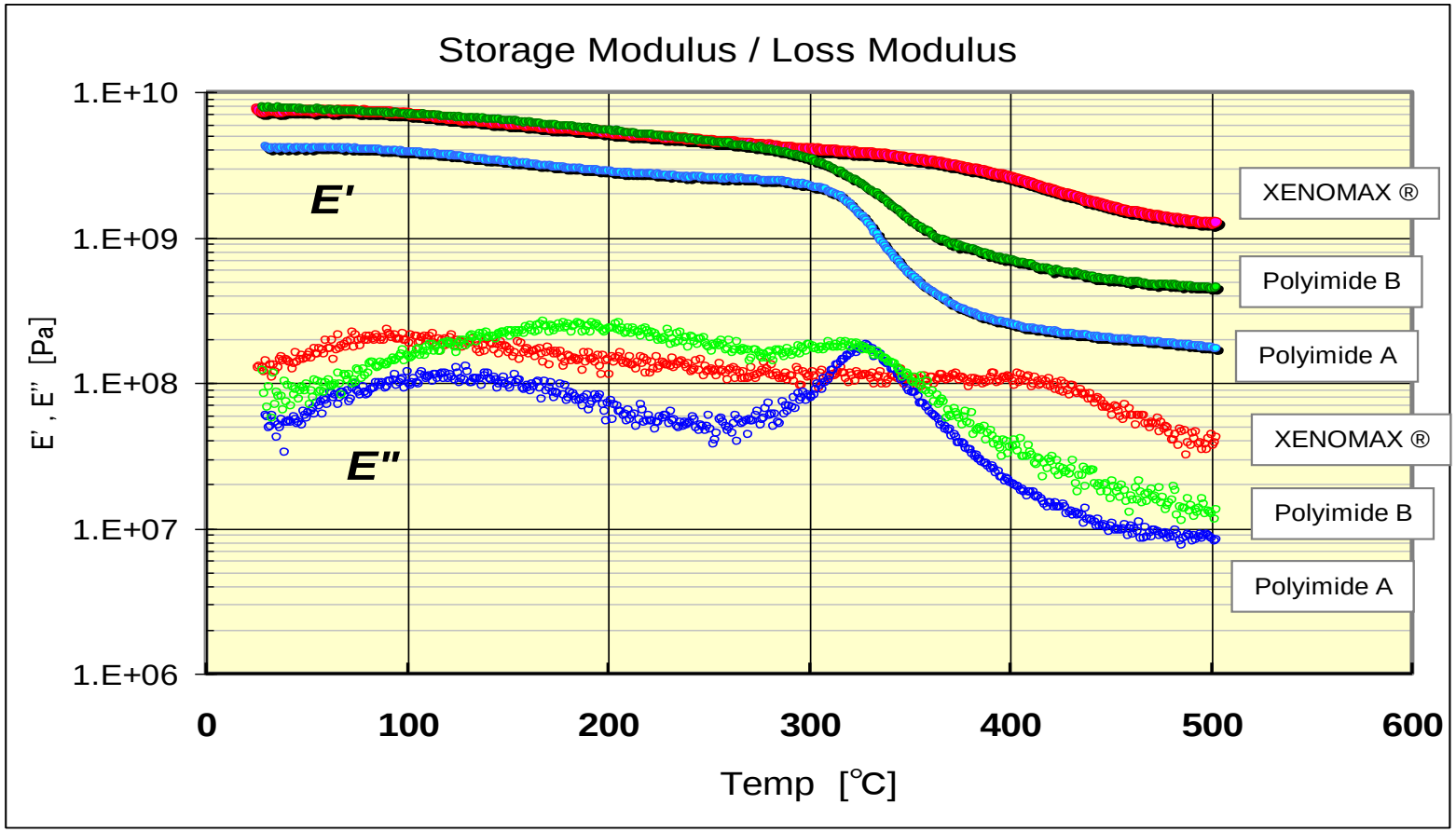
此数据为本公司测试值仅供参考

机械特性于电器特性

项目		单位	产品		测试方式
			38μm	15μm	
机械特性	杨氏模量	GPa	8.8	9.0	ASTM D882
	拉伸强度	MPa	450	580	ASTM D882
	拉伸破裂率	%	40	55	ASTM D882
	密度	g/cm^3	1.50	1.50	密度梯度管法、30℃
电气特性	表面阻抗率	Ω/□	$>10^{17}$	10^{17}	500V、23℃
	体积阻抗率	Ω・cm	$>10^{16}$	$>10^{16}$	500V、23℃
	比诱电率	-	3.3	3.3	1kHz
	诱电正接	-	0.008	0.008	
	绝缘破坏电压	kV	9.5	6.4	ASTM D149、50Hz

此数据为本公司测试值仅供参考

粘弹特性



此数据为本公司测试值仅供参考

■ 在高温（300℃以上）弹性率下降

→ 可使用在高温工艺

耐熱性：UL认证数据

厚度	阻燃性	HWI	HAI	RTI [℃]		D495	CTI
μm	UL94	PLC	PLC	Elec.	Str.	PLC	PLC
5	VTM-0	0	4	220	220	4	3
10	VTM-0	0	3	240	240	4	3
25	V-0	0	3	240	240	4	3
50	V-0	0	2	260	240	4	3

UL FILE No.QMFZ2.E247930

HWI：热线点火(PLC:0～5)
HAI：高电流电弧点火(PLC:0～4)
RTI：温度指标
(Elec：电气的強度、Str.：机械的強度)
D495：电弧阻力(0～7)
CTI：漏电比较(0～5)
PLC：指数(Performance Level Categories)